

NEUNMONATSBERICHT
01. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2003

KENNZAHLEN Q3/2003

Millionen Euro	Q3/2003	Q2/2003	Q1-Q3/2003	Q1-Q3/2002
Auftragseingang netto	26,1	25,0	76,4	83,6
Auftragsbestand netto	---	---	43,8	54,4
Nettoumsatz	21,4	21,6	60,6	84,7
Eigenkapital	---	---	107,0	119,2
Eigenkapitalquote	---	---	72,4%	67,7%
Net Cash	---	---	9,8	8,1
Free Cash Flow	-6,9	2,5	0,2	-2,9
Rohertrag	9,0	9,5	23,2	39,6
Rohertragsmarge	42,0%	43,8%	38,3%	46,7%
EBITDA	-0,3	-2,7	-10,5	-10,6
EAT (Ergebnis nach Steuern)	-1,3	-3,0	-10,1	-8,9
EPS (Ergebnis pro Aktie in Euro)	-0,09	-0,20	-0,67	-0,60
Mitarbeiter (Anzahl)	---	---	711	937

Editorial	4
Die ersten neun Monate 2003 im Überblick	8
Weltweit einzigartige Technologieneuheit: „nano PREP“	8
Pionier Mask Aligner mit modernster Technik ausgestattet	10
Neu in Auswahlindex TecDAX aufgenommen	11
SÜSS MicroTec baut Kapitalbasis weiter aus	12
Umsatz und Auftragslage	14
Umsatzentwicklung nach Produktlinien und Regionen	14
Auftragseingang nach Produktlinien und Regionen	15
Finanzbericht	16
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	16
Konzernbilanz	18
Konzernkapitalflussrechnung	20
Konzerneigenkapitalentwicklung	22
Rechnungslegungsgrundsätze / Segmentberichterstattung	22
Aktien und Bezugsrechte der Organe	24
Unternehmenskalender 2003	24



Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG,

im vergangenen dritten Quartal 2003 hielt die positive Grundstimmung in den Märkten der SÜSS MicroTec weiterhin an. Die wichtigsten Kunden sehen eine deutlich ansteigende Produktionsauslastung und es wird mit Zuversicht ins Jahr 2004 gesehen. Es ist jedoch auch nach wie vor eine große Verunsicherung ob der Nachhaltigkeit der Branchenerholung zu sehen. Dies zeigt sich insbesondere in der erst langsam schwindenden Zurückhaltung bei den Neuinvestitionen unserer Kunden in neues Produktionsequipment. Führende Research-Institute bestätigen diese Entwicklung: Während in der Halbleiterbranche früher bereits bei rund 85 Prozent Auslastung neues Equipment geordert wurde, wird diese Entscheidung heute gerne bis zu einer Auslastung von 90 Prozent und mehr hinausgezögert. Da sich inzwischen aber die Auftragslage unserer meisten Kunden ganz entscheidend verbessert hat, erwarten wir in den nächsten Monaten auch für die Equipmentindustrie steigende Auftragseingänge. SÜSS MicroTec wird an dieser Entwicklung in vollem Umfang teilhaben.

Wir haben weiter ein großes Augenmerk auf unsere Entwicklungsarbeiten, die am Markt auf großes Interesse stoßen. Das Feedback seitens

unserer Kunden über Demoläufe, insbesondere auf unserem Equipment mit neuen Technologien, ist sehr gut. Wir sind daher überzeugt, dass sich die nunmehr für 2004 erwartete Geschäftsbelebung auch entsprechend auf unsere Umsätze auswirken wird und unsere Entwicklungsarbeiten die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen. In diesem Zusammenhang ist auch die Umsatzverteilung nach Produktlinien im dritten Quartal zu erwähnen: Die Prober machten fast ein Drittel des Konzernumsatzes im abgelaufenen Quartal aus – die Folge eines Umsatzzanstiegs von 125 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Dieser Trend ist vor allem auf Produktneuheiten zurückzuführen, denn unsere technischen Neuentwicklungen wurden vom Markt hervorragend angenommen. Eine positive Entwicklung im Prober-Geschäft war in der Vergangenheit immer ein interner Frühindikator für einen kommenden Investitionszyklus; ebenfalls ein Indiz, das uns für die nähere Zukunft zuversichtlich macht.

Saisonal bedingt und analog zum Verlauf der letzten Jahre wird der Umsatz im laufenden vierten Quartal des Geschäftsjahres wieder deutlich gegenüber den Vorquartalen ansteigen. Infolge der Vorbereitung für diesen geplanten Umsatzzanstieg weist das dritte Quartal üblicherweise einen negativen operativen Cash Flow auf. Dieser Effekt zeigt sich auch in diesem Jahr. Die Lagerbestände konnten zum Ende des dritten Quartals, trotz der Vorarbeiten zu den geplanten Lieferungen im vierten Quartal, konstant gehalten werden. Dies ist vor allem auf einen ansteigenden Abverkauf aus dem bestehenden Fertiglager zurückzuführen. Einen weiteren Einfluss auf den Cash Flow im dritten Quartal hatte der deutliche Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten. Dabei handelt es sich vor allem um Sondereffekte, zum Beispiel Steuerzahlungen für 2001, die entsprechend zurückgestellt waren. Der Free Cash Flow der ersten neun Monate ist mit 0,2 Mio. Euro noch leicht positiv. Die Entwicklung des Free Cash Flow bewegt sich damit voll im Zielkorridor für das Gesamtjahr, da im vierten Quartal der Free Cash Flow ausgeglichen – bei günstigem Forderungsverlauf sogar leicht positiv – erwartet wird.

Besonders erwähnenswert ist die signifikante Eindämmung der Verlustsituation, auch im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal erreichten wir mit einem EBITDA von minus 0,3 Mio. Euro nahezu die Break Even-Schwelle. Dies führen wir vor allem auf die inzwischen wirksam

werdenden Kostenreduktionsmaßnahmen zum Ende des Geschäftsjahres 2002 und während des ersten Halbjahres 2003 zurück.

Für das vierte Quartal erwarten wir, wie in den vergangenen Jahren, wieder eine deutliche Umsatzsteigerung gegenüber den Vorquartalen. Die gesetzte Zielmarke, das Erreichen des Free Cash Flow Break Even, werden wir aus heutiger Sicht erreichen. Mit steigendem Umsatz wird sich auch die Ertragssituation erheblich verbessern. Aufgrund der gegenwärtigen Kostenstruktur wird schon bei nur leicht erhöhtem Umsatz gegenüber dem dritten Quartal die Gewinnschwelle (EBITDA) für das vierte Quartal erreicht, so dass wir für das vierte Quartal einen deutlich positiven Ertrag erwarten.

Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG, neben der Entwicklung der Geschäftszahlen war das zurückliegende Quartal für uns insbesondere von zwei weiteren – sehr unterschiedlichen – positiven Ereignissen geprägt: Aufnahme in den Auswahlindex TecDAX der Deutschen Börse und die Marktreife der „nano PREP“ Technologie.

Von „nano PREP“ erwarten wir eine deutliche Erweiterung unseres Marktpotentials, da diese Technologie weltweit einzigartig ist und die Produktion unserer Kunden damit erheblich optimiert wird, sowohl auf der Produktionsergebnis- als auch auf der Kostenseite. „nano PREP“, einsetzbar in allen SÜSS Produktions-Bondclustern, ist für die weitere Entwicklung des Zukunftsmarkts der Mikrosystemtechnik sicherlich von großer Bedeutung. Nähere Angaben zu dieser unserer neuesten Entwicklung lesen Sie bitte auf Seite 8.

Mit den neuen Technologien „SupraYield“ (bereits im zweiten Quartal vorgestellt) und „nano PREP“ haben wir ganz wesentliche Neuheiten in den Markt eingeführt. Für beide Technologien wurden erste Kunden gewonnen, die damit in die Produktion gehen. Dies wird auch einen erheblichen Einfluss auf die Umsatzentwicklung der SÜSS MicroTec-Gruppe in den nächsten Jahren haben.

Mit dem neuen Labor-Mask Aligner MJB4 (Seite 10) betreiben wir Produktpflege an unseren bestehenden Produktlinien. Das MJB4 ist das

neue Einsteigermodell für Mask Aligner, das vor allem in der Forschung und Entwicklung verwendet werden wird. Es ersetzt das MJB3, das sich in den vergangenen 30 Jahren einen schon legendären Ruf als das Standardmodell für Universitäten erworben hat.

Mit den neuen Entwicklungen ist die SÜSS MicroTec für weiteres Wachstum hervorragend positioniert und setzt gleichzeitig neue Standards für die Zukunftsmärkte der Halbleiterbranche. Die positiven Rückmeldungen unserer Kunden bestätigen: Mit unseren effizienten, kostengünstigen und hochwertigen Technologien wird SÜSS MicroTec bei ansteigenden Investitionen im Markt für Halbleiter-Equipment verstärkt profitieren.

Ganz aktuell gilt es noch die von der SÜSS MicroTec AG vor einigen Tagen begebene Wandel- und Optionsanleihe zu erwähnen (Seite 11). Durch diese Transaktion stehen dem Unternehmen unmittelbar zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 11.642.000,00 Euro zur Verfügung und, je nach Kursverlauf, später möglicherweise weitere 3.570.786,00 Euro. Unser Ziel bei dieser Kapitalmaßnahme ist die Schaffung einer Liquiditätsposition, die zur Finanzierung des erwarteten Wachstums und zu mehr Flexibilität bei der Umsetzung unserer langfristigen Strategien führt.

Garching, im November 2003



Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender



Stephan Schulak
Vorstand Finanzen

I DIE ERSTEN NEUN MONATE 2003 AUF EINEN BLICK

Weltweit einzigartige Technologieneuheit für das Verbinden von Wafern: „nano PREP“

SÜSS MicroTec hat sich in den vergangenen Monaten mit der Produktentwicklung verstärkt auf den Bereich Mikrosystemtechnik konzentriert. Die Mikrosystemtechnik nimmt immer mehr an Bedeutung zu, da die Miniaturisierung von Bauteilen zur Erhöhung der Leistung längst auch mechanische oder andere nicht-elektrische Funktionen erfasst hat. Als Beispiel können hier Hochleistungs-Tintenstrahldruckköpfe oder hoch auflösende Kippspiegel-Displays genannt werden. Solche hohen Anforderungen aus unserem inzwischen High-Tec-Alltag erfordern komplexeste mikrosystemtechnische Bauteile, die in der Regel aus verschiedenen Silizium-Wafern aufgebaut werden müssen. Die Silizium-Wafer werden zunächst separat gefertigt und werden dann flächig miteinander verbunden oder „gebondet“. Der Begriff „Direktes Wafer Bonden“ bezeichnet das permanente Verbinden von zwei oder mehr Silizium-Wafern, wobei die Verbindung zwischen den Atomgittern des Siliziums zu Stande kommt. Dabei ergibt sich das Problem, wie diese Wafer mit all den bereits aufgetragenen Strukturen sicher gebondet werden können – ohne dass die Strukturen auf dem Silizium-Wafer wieder zerstört werden. Bondprozesse mit großer Hitzeeinwirkung (im Bereich von bis zu 1.000 Grad Celsius) sind daher ungeeignet und scheiden aus diesem Grunde aus.

Um Prozesstemperaturen im Bereich von 1.000 Grad Celsius beim Bonden von Silizium zu vermeiden, müssen entweder Hilfsmaterialien eingeführt werden (Silizium-Glas-Silizium anstatt Silizium-Silizium) oder es müssen spezielle Präparationsschritte zur Vorbehandlung der Siliziumoberflächen vorgenommen werden. Durch geeignete Vorbehandlung, die bisher nur in aufwendigen Vakuumprozessen erfolgen konnte, kann Silizium direkt mit Silizium bei einer Temperatur von 200 bis 300 Grad Celsius sicher gebondet werden. SÜSS MicroTec hat zusammen mit Partnern in diesem Bereich intensive Prozessentwicklung betrieben und ein neues Verfahren für das Direkte Wafer Bonden entwickelt.

Die Technologieneuheit „nano PREP“ ist ein spezieller Prozessschritt beim Direkten Wafer Bonden: Die Oberflächen der Silizium-Wafer werden einer speziellen Plasmabehandlung in Atmosphärendruck unterzogen. Dabei werden die Oberflächen im molekularen Bereich verändert, indem

Molekülgruppen, die als Verbindungselemente fungieren (chemisch: OH-Gruppen) an die Oberflächen angelagert werden. Beim Kontaktieren der Silizium-Wafer miteinander „schnappen“ diese förmlich zusammen (van-der-Vaals-Kräfte). Das anschließende „Tempern“ oder „Ausbonden“, das dann die permanente Verbindung erzeugt, kann bei einer drastisch reduziert Temperatur erfolgen (200 Grad Celsius statt bisher ca. 1.000 Grad Celsius).

SÜSS MicroTec treibt mit dem „nano PREP“-Verfahren die Reduktion der Produktionskosten im Bereich Mikrosystemtechnik weiter voran. Mit diesem Verfahren können alle SÜSS Bondcluster ausgestattet werden, die als vollautomatische Produktionstools für die Mikrosystemtechnik schon bisher die Zielrichtung der Effizienzsteigerung in der Produktion verfolgten. Insbesondere hinsichtlich Automatisierungsgrad und „Footprint“ (Platzbedarf im Reinraum) – und damit der Wirtschaftlichkeit in der Produktion – sind diese Geräte den Wettbewerbsangeboten deutlich überlegen. Der höhere Automatisierungsgrad führt in der Regel auch zu einer Verbesserung der Ausbeute oder des „Yields“ in der Produktionslinie.

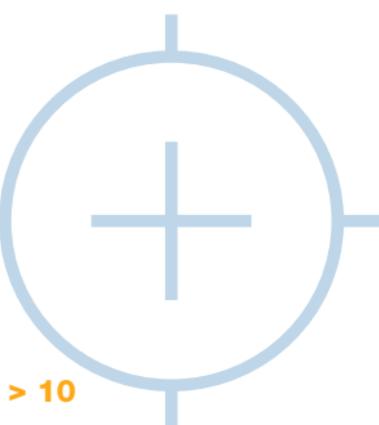
SÜSS MicroTec, als langjähriger Equipment-Lieferant für die Mikroelektronikindustrie, hat sich dem Ziel „Yield-Erhöhung“ verpflichtet – insbesondere in der Mikrosystemtechnik, wo die typischen Yield-Werte heute noch deutlich hinter denen der Mikroelektronik zurückliegen. Dies ist ein entscheidender Entwicklungsschritt, denn die Mikrosystemtechnik ist in vielen Branchen auf starkem Wachstumskurs. Besonders in der Automobilindustrie, Telekommunikation, Computer- sowie Medizintechnik nimmt der Einsatz der leistungsfähigen und sehr vielfältigen „Miniwelten“ stetig zu. Beispielsweise wären die Druckköpfe bei Tintenstrahldruckern, die Biomedizin oder die gesamte Sensortechnik (Airbags, GPS-Systeme, Reifendrucksensoren u.v.m.) in Autos ohne Mikrosysteme undenkbar.

Das Garchingener Unternehmen entwickelte „nano PREP“ in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut und dem Fraunhofer Institut IST. Die neue Technologie zur Plasma-Oberflächenbehandlung ist bereits zum Patent angemeldet. Auch künftig wird SÜSS MicroTec gemeinsam mit seinen Partnern Prozessentwicklung für den Zukunftsmarkt Mikrosystemtechnik betreiben und einer der Vorreiter für die weitere Verfeinerung der Mikrosystemtechnologien sein.

Pionier Mask Aligner mit modernster Technik ausgestattet

MJB3 – hinter diesem schlichten Kürzel verbirgt sich eines der traditionsreichsten SÜSS MicroTec-Produkte: einer der ersten SÜSS Mask Aligner, der damals noch ganz Deutsch „Masken Justier- und Belichtungsgerät“ hieß. 1969 kam das kleine, seinerzeit hochmoderne und hochgenaue, manuelle Gerät für die Photolithografie auf den Markt – und gehörte schnell zu den ganz Großen seiner Produktlinie: Mit weltweit über 2.000 installierten Systemen wurde der MJB3, in verschiedenen Überarbeitungsstufen, der meistverkaufte SÜSS MicroTec-Mask Aligner. In Universitäten und Forschungsinstituten ist er seit über drei Jahrzehnten das Standardgerät zur Lithografieforschung und -entwicklung bei bis zu 3-Zoll-Wafern.

Heute sind 3-Zoll-Siliziumwafer nur noch schwer zu bekommen. Auch in Forschungseinrichtungen werden heute fast ausschließlich 4-Zoll-Wafer eingesetzt. Damit der legendäre kleine Mask Aligner auch künftig Meilensteine in der Lithographieentwicklung setzen kann, hat SÜSS MicroTec nun den Nachfolger des MJB3, den MJB4, auf den Markt gebracht und dabei mit der neuesten Technik hinsichtlich der Steuerung und Bedienung ausgestattet. Basierend auf den bewährten mechanischen Grundprinzipien des MJB3, knüpft der MJB4 an die traditionellen Eigenschaften seines Vorgängers an: größte Zuverlässigkeit, höchste Präzision und beste Qualität – und manuell versteht sich.



Neu in Auswahlindex TecDAX aufgenommen

Die SÜSS MicroTec AG wird seit 22. September 2003 im TecDAX geführt – und ist damit im Auswahlindex der Deutschen Börse für Technologieunternehmen vertreten.

Der TecDAX umfasst die 30 größten Technologiewerte des Qualitätssegments Prime Standard der Deutschen Börse. Kriterien für die Aufnahme in den Auswahlindex TecDAX sind jeweils die Börsenumsätze in den vergangenen 12 Monaten sowie die Freefloat-Marktkapitalisierung zum Untersuchungszeitpunkt. Entscheidungsgrundlage für die Aufnahme von SÜSS MicroTec in den TecDAX bildeten die entsprechenden Ranglisten zum Stichtag 31. Juli 2003. SÜSS MicroTec konnte zum gegebenen Stichtag beide Aufnahmekriterien voll erfüllen; die Entscheidung der Deutschen Börse über die Aufnahme fiel dann am 19. August 2003.

Die Aufnahme in den TecDAX ist für den Vorstand der SÜSS MicroTec AG Verpflichtung und Herausforderung gegenüber den Investoren, die größtmögliche Unternehmenstransparenz – und damit verbunden eine kontinuierliche Berichterstattung – zu wahren. Als „TechDAX Unternehmen“ ist SÜSS MicroTec nun auch wieder mehr in den Aufmerksamkeitsbereich von institutionellen und privaten Investoren gekommen, so dass das Unternehmen mittlerweile wieder von zehn namhaften nationalen und internationalen Bank- bzw. Investmenthäusern im Rahmen einer Coverage betreut wird.

SÜSS MicroTec baut Kapitalbasis weiter aus

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat Anfang November mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandel- und Optionsanleihe im Gesamtbetrag von EUR 11.642.000,00 auszugeben.

Vereinfacht ausgedrückt, sind Wandelanleihen (engl. Convertible Bonds) Schuldverschreibungen einer AG mit fester Verzinsung. Investoren gewähren der AG gegen diese Schuldverschreibung ein Darlehen über einen definierten Zeitraum zu einem festen Zinssatz. Darüber hinaus haben die Gläubiger (Investoren) das Recht, während der Laufzeit zu einem heute bereits festgelegten Kurs – meistens Durchschnittskurs plus Aufschlag – das Darlehen gegen Aktien der Gesellschaft umzutauschen.

Mit Ausübung dieses Wandlungsrechts erlischt das Forderungsrecht auf Rückzahlung der Darlehens. Der Gläubiger wird zum Aktionär. Die Entscheidung über die Wandlung trifft der Gläubiger. Für die Wandlung ist der Börsenkurs der Aktie maßgeblich; der Umtausch lohnt sich, wenn der Börsenkurs mindestens über dem festgelegten Wandlungspreis liegt

Wenn der Gläubiger die Wandelanleihe nicht in Aktien tauscht, bekommt er am Ende der Laufzeit sein eingesetztes Kapital von der AG zum Nennwert zurück. Zwischenzeitlich bekommt er Zinsen, wobei diese bei Wandelanleihen meist deutlich unter denen von herkömmlichen Anleihen liegen.

Weitere Details: Von den EUR 11.643.000,00 insgesamt entfallen EUR 11.268.730,00 auf eine Wandelanleihe, die mit 6% p.a. verzinst wird und in zwei gleichen Tranchen am 31. Oktober 2005 und am 30. April 2006 rückzahlbar ist, sofern sie nicht während dieser Laufzeit in bis zu 1.119.810 Aktien der SÜSS MicroTec AG umgewandelt wird. Der Wandlungspreis hierfür beträgt EUR 10,063075 pro Aktie und liegt damit 15% über dem durchschnittlichen XETRA-Börsenkurs der SÜSS MicroTec Aktien während der letzten 20 Handelstage vor dem 4. November 2003.

Des weiteren entfallen EUR 373.270,00 auf eine Optionsanleihe, die gleichfalls mit 6% p.a. verzinst wird und, vorbehaltlich Ausübung von

Bezugsrechten auf Aktien, am 31. Oktober 2008 rückzahlbar ist. Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine Aktie der SÜSS MicroTec AG verbunden. Der Bezugspreis je Aktie beträgt EUR 10,566229 und liegt damit um 5% über dem Wandlungspreis. Er ist zahlbar durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuzüglich Barzahlung von EUR 9,566229 je Aktie.

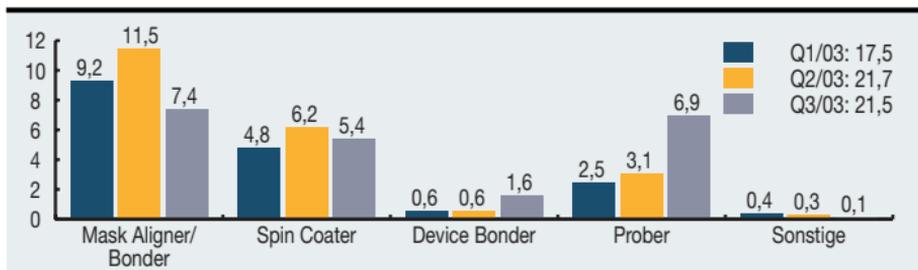
Die Gesellschaft setzt damit einen Beschluss der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 um. Die Wandel- und Optionsanleihe wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an eine englisch-amerikanische Investorengruppe begeben. Der führende Investor der Transaktion war The Tail Wind Fund Ltd., die von der Tail Wind Advisory & Management, London, (TWAM) geleitet wird. Die offizielle Regulierungsbehörde für die TWAM ist die Financial Services Authority in England.

Aufgrund der derzeit niedrigen Zinsen und der hohen Aktienkurschwankungen ist derzeit das Kapitalmarktumfeld für Wandelanleihen sehr günstig. SÜSS MicroTec hat sich zu dieser Kapitalmaßnahme entschlossen, um mit dem Erlös aus dieser Emission die notwendige Liquidität für das in 2004 erwartete Wachstum aus mittelfristigen Finanzmitteln zu bedienen sowie um eine größere Flexibilität bei der Umsetzung der langfristigen Strategien von SÜSS MicroTec zu erzielen.

Der Gesamtumsatz von 21,4 Mio. Euro in Q3/2003 bzw. von 60,6 Mio. Euro in Q1-Q3/2003 teilt sich nach Produktlinien und Regionen wie folgt auf:

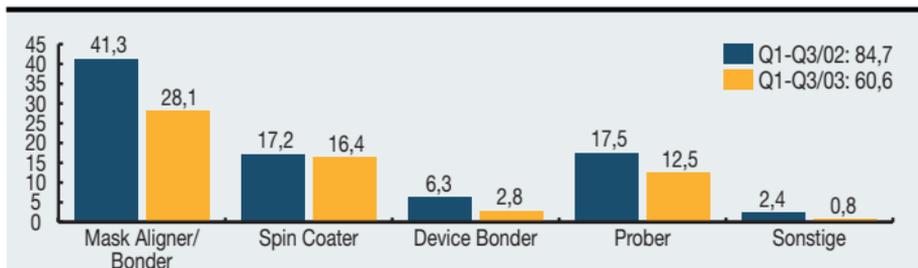
Umsatzentwicklung nach Produktlinien (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



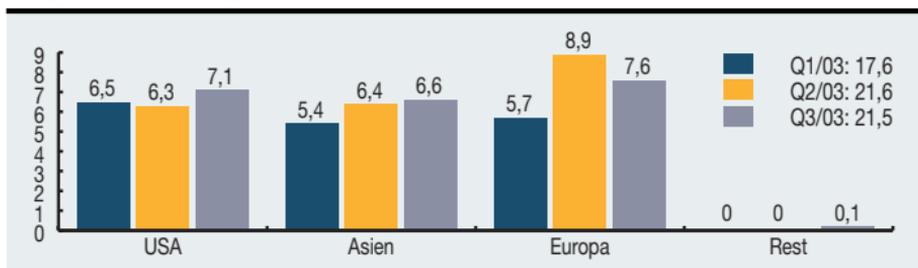
Umsatzentwicklung nach Produktlinien (9 Monate)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



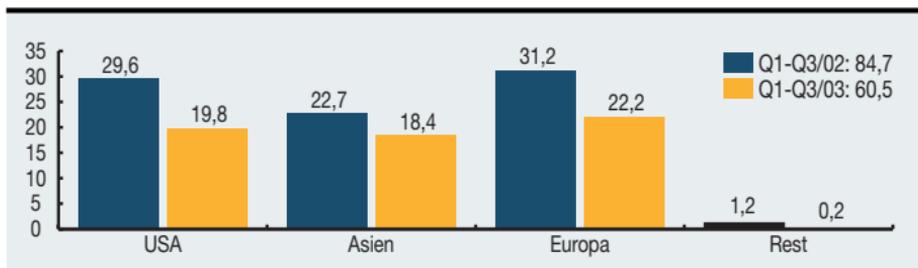
Umsatzentwicklung nach Regionen (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Umsatzentwicklung nach Regionen (9 Monate)

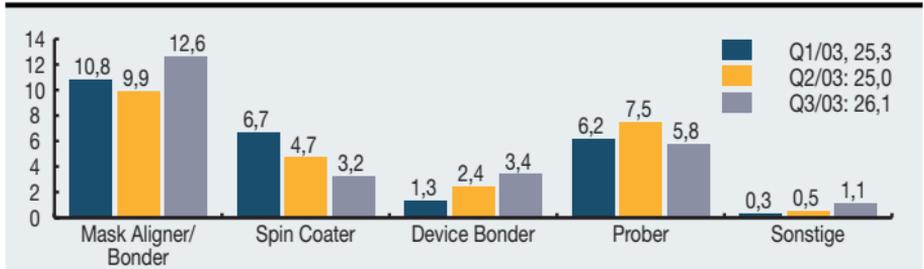
Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Der Auftragseingang von 26,1 Mio. Euro in Q3/2003 bzw. von 76,4 Mio. Euro in Q1-Q3/2003 teilt sich nach Produktlinien und Regionen wie folgt auf:

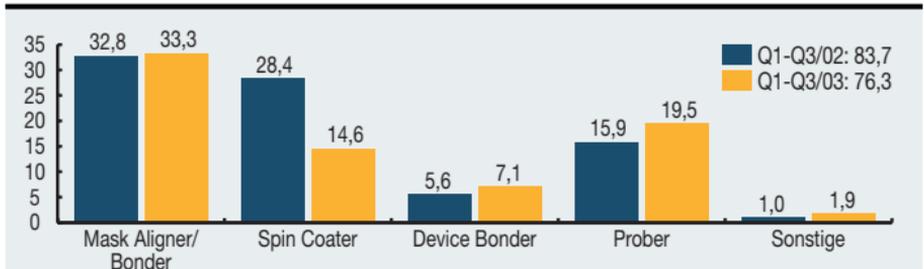
Auftragseingang nach Produktlinien (Quartale)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



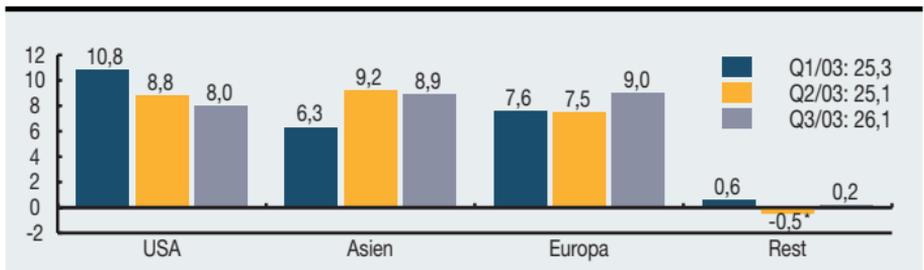
Auftragseingang nach Produktlinien (9 Monate)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Auftragseingang nach Regionen (Quartale)

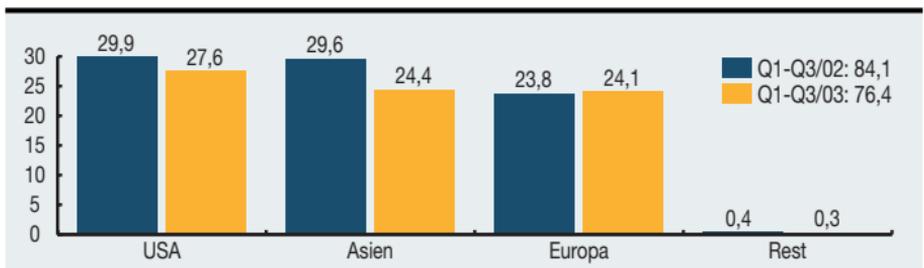
Angaben im Vergleich in Mio. Euro



*Umgliederung

Auftragseingang nach Regionen (9 Monate)

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



SÜSS MicroTec AG

KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR	01.07.2002- 30.09.2002*
Umsatzerlöse	29.764
Frachtkosten und Provisionen	-1.450
Umsatzerlöse netto	28.314
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	15.511
Bruttoergebnis vom Umsatz	12.803
Allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten	-12.996
Forschungs- und Entwicklungskosten	-3.803
Abschreibung des Firmenwerts	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge	-1.072
Erträge / Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung	-332
Operatives Ergebnis	-5.400
Zinsaufwendungen	-235
Zinserträge	124
Anteil der Minderheitsaktionäre am Ergebnis	0
Ergebnis vor Steuern	-5.511
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.681
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-2.830
Earnings before Interest and Taxes (EBIT)*	-5.400
Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)*	-4.077
Pro Aktie:	
Unverwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR	-0,19
Verwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR	-0,19

Überleitung zum Comprehensive Income

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-2.830
Sonstiges Comprehensive Income nach Steuern	
Fremdwährungsdifferenzen	159
Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung	0
Comprehensive Income	-2.671

* ungeprüft

01.01.2002- 30.09.2002*	01.01.2002- 31.12.2002	01.07.2003- 30.09.2003*	01.01.2003- 30.09.2003*
88.398	132.379	21.973	62.438
-3.672	-4.864	-533	-1.824
84.726	127.515	21.440	60.614
45.164	79.598	12.432	37.401
39.562	47.917	9.008	23.213
-42.041	-48.006	-9.984	-31.306
-10.005	-12.537	-1.908	-6.826
0	0	0	0
-147	-401	977	1.601
-2.337	-3.319	152	-1.877
-14.968	-16.346	-1.755	-15.195
-887	-1.309	-330	-955
407	479	114	293
0	6	4	-18
-15.448	-17.170	-1.967	-15.875
6.578	8.232	628	5.731
-8.870	-8.938	-1.339	-10.144
-14.968	-16.340	-1.751	-15.213
-10.579	-9.535	-288	-10.458
-0,60	-0,60	-0,09	-0,68
-0,60	-0,60	-0,09	-0,67
-8.870	-8.938	-1.339	-10.144
-1.739	-3.192	-20	-1.860
0	-42	0	0
-10.609	-12.172	-1.359	-12.004

SÜSS MicroTec AG

KONZERNBILANZ

TEUR	30.09.2002*	31.12.2002	30.09.2003*
AKTIVA			
Flüssige Mittel	15.534	16.914	13.040
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	27.413	34.105	18.142
Sonstige kurzfristige Forderungen	3.558	9.249	4.914
Vorräte, netto	61.386	48.062	47.622
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	621	958	862
Kurzfristige aktive latente Steuern	7.237	3.405	4.632
Summe Umlaufvermögen	115.749	112.693	89.212
Sachanlagen	18.009	16.592	13.471
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.478	9.679	7.922
Goodwill	28.009	28.009	28.009
Finanzanlagen	147	148	148
Langfristige aktive latente Steuern	639	4.895	7.175
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	2.161	1.940	1.889
Summe Aktiva	176.192	173.956	147.826

* ungeprüft

TEUR	30.09.2002*	31.12.2002	30.09.2003*
PASSIVA			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	7.403	3.531	3.240
Kurzfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	462	275	154
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.327	3.934	3.751
Kurzfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	361	223	223
Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	2.663	3.546	2.917
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	22.353	24.432	14.130
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	39.569	35.941	24.415
Langfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	11.793	14.501	11.585
Langfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	649	613	509
Langfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	3.558	3.580	3.653
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.406	735	621
Minderheitenanteil an Konzerngesellschaften	0	52	37
Summe langfristige Verbindlichkeiten	17.406	19.481	16.405
Gezeichnetes Kapital / Genehmigte Anzahl von Aktien zu EUR 1,00 (in tsd.) 22.423 (31.12.2002 und 30.09.2003); davon ausgegeben (in tsd.) 14.957 (31.12.2002 und 30.09.2003)	14.957	14.957	14.957
Kapitalrücklage	80.031	80.911	81.387
Gewinnrücklagen	433	433	433
Gewinnvortrag	25.705	25.637	15.493
Kumuliertes Other Comprehensive Income	-1.909	-3.404	-5.264
Summe Eigenkapital	119.217	118.534	107.006
Summe Passiva	176.192	173.956	147.826

* ungeprüft

SÜSS MicroTec AG

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.2002- 30.09.2002*	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2003- 30.09.2003*
Mittelzufluss aus der laufenden			
Geschäftstätigkeit			
Jahresfehlbetrag	-8.870	-8.938	-10.144
Wechselkursbedingte Veränderung des Eigenkapitals	-491	-1.505	-913
Anpassung zur Überleitung des Jahresfehlbetrages/ -überschusses zum Mittelzufluss aus der lfd.			
Geschäftstätigkeit			
Zuführung zur Kapitalrücklage für Bezugsrechte	861	1.430	476
Steuereffekt auf Kosten der Kapitalerhöhung	0	514	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.651	2.200	1.412
Abschreibung auf den Goodwill	0	0	
Verminderung Finanzanlagen durch Änderung im Konsolidierungskreis	0	106	0
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	2.755	4.174	2.988
Abschreibungen auf Leasinggegenstände	252	547	356
Veränderung der aktiven latenten Steuern	-2.132	-2.556	-3.507
Verlust / Gewinn aus Abgang von Anlagegegenständen	282	-20	37
Gewinn aus Beteiligungen	0	-1	0
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	-495	-167	135
Veränderung der Wertberichtigung auf Vorräte	290	811	843
Veränderungen von Aktiva und Passiva			
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.886	16.866	15.828
Veränderung der Vorräte	-616	15.047	-403
Veränderung des aktiven Rechnungsab- grenzungspostens	437	100	96
Veränderung der sonstigen Aktiva	-425	-5.895	4.386
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.150	-3.543	-183
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	-12.185	-10.106	-10.302
Veränderung der Pensionsverbindlichkeiten	-127	-243	73
Veränderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten	-2.102	-2.721	-129
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.821	6.100	1.049

* ungeprüft

TEUR	01.01.2002- 30.09.2002*	01.01.2002- 31.12.2002	01.01.2003- 30.09.2003*
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-3.878	-2.935	-825
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1.280	-139	-38
Auszahlungen für Unternehmenserwerb	0	-3.356	0
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Finanzanlagen	413	203	1
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.745	-6.227	-862
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit			
Aufnahme von Bankdarlehen	0	5.677	0
Tilgung von Bankdarlehen	-580	-2.666	-3.545
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-22.119	-25.991	-291
Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	89	-844	-225
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	33.609	34.465	0
Einzahlungen aus Ausübung von Bezugsrechten	0	317	0
Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhung	0	-1.376	0
Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	10.999	9.582	-4.061
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes			
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	625	-239	-724
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	6.834	7.698	17.638
Finanzmittelbestand zum Ende der Periode	15.534	16.914	13.040
Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung			
Zinszahlungen während der Periode	960	1.103	1.017
Einkommensteuererstattungen/-zahlungen während der Periode incl. Vorauszahlungen	2.491	3.304	-871
Zusätzliche Darstellung nichtzahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungstätigkeiten			
Zugang zum Finanzierungsleasing	247	710	33

* ungeprüft

SÜSS MicroTec AG

KONZERNEIGENKAPITALENTWICKLUNG

TEUR	Anzahl der Aktien in tausend Stück	Gezeichnetes Kapital
Stand 01.01.2002	13.802	13.802
Zuführung aufgrund Kapitalerhöhung	1.130	1.130
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Zuführung aufgrund Ausübung von Bezugsrechten	25	25
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung, nach Steuereffekt		
Stand 30.09.2002	14.957	14.957
Stand 01.01.2003	14.957	14.957
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung, nach Steuereffekt		
Stand 30.09.2003	14.957	14.957

Rechnungslegungsgrundsätze

Die dargestellten Angaben zum Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG entsprechen den Vorschriften der US-amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles („US-GAAP“). Der Zwischenabschluss zum 30. Juni 2003 wurde unter Beachtung derselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, die auch dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2002 zugrunde lagen und im Anhang ausführlich erläutert wurden.

Segmentberichterstattung

Die SÜSS MicroTec AG und ihre Tochterunternehmen sind lediglich in einem Segment tätig. Eine Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Segmente entfällt aus diesem Grund.

Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Gewinnvortrag	Kumuliertes Other Compre- hensive Income	Gesamt
46.716	433	34.575	-170	95.356
32.162				33.292
861				861
292				317
		-8.870		-8.870
			-1.739	-1.739
80.031	433	25.705	-1.909	119.217
80.911	433	25.637	-3.404	118.534
476				476
		-10.144		-10.144
			-1.860	-1.860
81.387	433	15.493	-5.264	107.006

SÜSS MicroTec AG

AKTIEN UND BEZUGSRECHTE DER ORGANE UNTERNEHMENSKALENDER

Aktien und Bezugsrechte der Organe	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
	31.12.2002	31.12.2002	30.09.2003	30.09.2003
Vorstand				
Dr. Richter	400.000	65.000	400.000	105.000
S. Schulak	0	286	0	40.286
Aufsichtsrat				
Dr. Süß (Vors.)	1.039.780	0	1.104.780	0
T. Schlytter-Henrichsen (stellv. Vors.)	6.909	0	6.909	0
Dr. Schücking	500	0	500	0
Prof. Dr. Heuberger	0	0	0	0
Dr. Sesselmann	0	0	0	0
H. Görtz	3.894	0	3.894	0

Unternehmenskalender 2003

03.12.-05.12. SEMICON Japan, Chiba

SÜSS MicroTec AG

Schleissheimer Straße 90
D-85748 Garching

Telefon: (+49)-(0) 89/3 20 07-0
Fax: (+49)-(0) 89/3 20 07-450

E-Mail: ir@suss.de

www.suss.de